

- 1) Navesti prednosti protoboard-ova.
- 2) Navesti nedostatke protoboard-ova.
- 3) Navesti prednosti štampanih ploča.
- 4) Navesti nedostatke štampanih ploča.
- 5) Pravila rutiranja za linije napajanja.
- 6) Pravila rutiranja za linije signala.
- 7) Izraziti 1 inč (1") u cm.
- 8) Vrste komponenti prema načinu montaže na štampanu ploču.
- 9) Navesti parametre otpornika.
- 10) Navesti parametre kondenzatora.
- 11) Navesti razloge i način upotrebe kondenzatora na linijama napajanja integrisanih kola.
- 12) Za šta se koriste vie?
- 13) Navesti opšte osobine Circuit Maker-a.
- 14) Nacrtati oblik i naznačiti dimenzije otpornika u 0603 kućištu.
- 15) Koja je mana kalajnog kupatila i kako se rešava?
- 16) Kako se postavljaju komponente na štampanu ploču?
- 17) Koja je funkcija fluksa kod lemljenja?
- 18) Koja je uloga difuznih sila kod lemljenja SMD komponenti?
- 19) Koji su najčešći problemi kod SMD lemljenja u pećima (reflow soldering) i zašto se javljaju?
- 20) Navesti primere žice za lemljenje u prehrambenoj industriji i van nje.
- 21) Objasniti za šta se koristi prečica CTRL + M u Circuit Maker-u.
- 22) Navesti koji merni sistemi su podržani u Circuit Maker-u?
- 23) Objasniti za šta se koristi prečica L u Circuit Maker-u.
- 24) Objasniti za šta se koristi prečica F u Circuit Maker-u.
- 25) Navesti vrste grafičkih prikaza štampane ploče i prečice kojima se pozivaju.
- 26) Objasniti ulogu komandi desni klik + povlačenje, CTRL + scroll dugme, SHIFT + desni klik i 0 u 3D prikazu štampane ploče.
- 27) Objasniti za šta se koristi prečica SHIFT + S u Circuit Maker-u.
- 28) Objasniti ulogu top, bottom i multilayer-a.
- 29) Objasniti ulogu overlay, paste i solder layer-a u izradi štampane ploče.
- 30) Navesti opsege vrednosti koji se najčešće koriste kod R, L, C komponenti na štampanim pločama.

31) 10 piko je 10 na koji stepen?

32) Koje vrste rutiranja postoje u Circuit Maker-u i za šta se koriste?

33) Šta sadrže gerber i NCdrill fajlovi i za šta se koriste?